

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

3 公司在本报告书中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”

4 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

5 公司全体董事出席董事会会议。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

一 公司基本情况

2.1 公司简介

□股票代码
√适用 □不适用

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司中文名称简况
□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露事务代表)	证券事务代表
姓名	李伟	王旭
办公地址	上海市长江路865号5号楼4楼	上海市静安区南京西路1000号4楼
电话	021-52589038	021-52589038
电子邮箱	peish@ssg.com	peish@ssg.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,175,273.28	996,324.41	17.96%
归属于上市公司股东的净资产	749,763.60	507,201.00	47.82%
经营活动产生的现金流量净额	2,736.44	1,743.83	56.92%
营业收入	85,427.37	65,446.24	30.53%
归属于上市公司股东的净利润	-8,259.42	-7,496.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,269.96	-11,784.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-1.76	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.58	5.90	增加16.8个百分点

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 74,610

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	质押或冻结的股份占总股份的比例
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	7.03	174,272,600	174,272,600	174,272,600	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	其他	6.53	162,000,000	162,000,000	162,000,000	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	6.53	162,000,000	162,000,000	162,000,000	无
上海新昇半导体科技股份有限公司	境内非国有法人	5.63	139,653,500	139,653,500	139,653,500	无
中航投资有限责任公司-中国工商银行混合型证券投资基金(有限合伙)	其他	4.15	102,827,763	102,827,763	102,827,763	无
中国工商银行股份有限公司-富国成长策略灵活配置证券投资基金	其他	1.43	35,471,104	0	0	无
建信养老金产品-境内法人	境内法人	0.76	17,452,800	17,452,800	17,452,800	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	其他	0.56	14,009,400	14,009,400	14,009,400	无

2.3 前十名股东持股情况

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	质押或冻结的股份占总股份的比例
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	7.03	174,272,600	174,272,600	174,272,600	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	其他	6.53	162,000,000	162,000,000	162,000,000	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	国有法人	6.53	162,000,000	162,000,000	162,000,000	无
上海新昇半导体科技股份有限公司	境内非国有法人	5.63	139,653,500	139,653,500	139,653,500	无
中航投资有限责任公司-中国工商银行混合型证券投资基金(有限合伙)	其他	4.15	102,827,763	102,827,763	102,827,763	无
中国工商银行股份有限公司-富国成长策略灵活配置证券投资基金	其他	1.43	35,471,104	0	0	无
建信养老金产品-境内法人	境内法人	0.76	17,452,800	17,452,800	17,452,800	无
上海集成电路产业基金(有限合伙)	其他	0.56	14,009,400	14,009,400	14,009,400	无

2.4 前十名境内存在限售情况

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

半导体行业市场规模总体呈现波动上升趋势,下游应用需求以及自身产能等因素存在密切关联,行业整体处于调整期,晶圆上升趋势,半导体硅片市场基本跟随半导体行业整体趋势同步波动。

2020年上半年,受新冠肺炎疫情及国际贸易和科技竞争环境扰动的影响,全球半导体行业受到较大冲击,但下游消费市场行业不同受到的影响程度有所不同。市场调研机构IDC统计显示2020年上半年出货量较上年同期同比下降约18.2%;笔记本电脑、平板电脑等,受益于远程办公的需求,出货量相对平稳;消费电子需求下滑,全球汽车销量大幅下滑,汽车电子需求显著下降。公司作为半导体产业链上游的集成电路设备,需求提升,同时因交通運輸和人员往来受阻,公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响,但目前生产运营均已恢复正常。

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内,公司制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

一 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航重机	600765	

联系人和联系方式

姓名	职务	姓名	职务
王旭	董事会秘书	王旭	证券事务代表
0851-88600765	电话	0851-88600765	电话
贵州省贵阳市双龙航空经济园区天开国际A3栋5层	办公地址	贵州省贵阳市双龙航空经济园区天开国际A3栋5层	办公地址
zhjg@163.com	电子邮箱	zhjg@163.com	电子邮箱

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,375,886,192.19	14,380,016,683.94	6.93
归属于上市公司股东的净资产	6,086,582,394.63	6,129,942,085.83	-0.69
经营活动产生的现金流量净额	53,265,769.47	-61,202,318.50	
营业收入	3,263,389,874.72	2,895,939,646.14	12.71
归属于上市公司股东的净利润	119,808,516.63	103,399,339.05	15.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,615,186.46	100,044,858.32	18.56
加权平均净资产收益率(%)	1.94	2.40	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州航天航空测控有限责任公司	国有法人	24.41	229,369,200	0	无
中航商用航空工业集团有限责任公司	国有法人	6.87	64,538,800	0	无
中航重机股份有限公司	国有法人	6.24	58,616,647	58,616,647	无
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.99	46,893,317	46,893,317	无
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.87	17,584,994	17,584,994	无
航空基金管理有限公司-北京国发航空基金管理有限公司-中航基金	国有法人	1.84	17,265,354	0	无
中航汇金资产管理有限公司	未知	1.81	16,963,500	0	未知
广东证券股份有限公司	境内非国有法人	1.62	15,240,328	15,240,328	无
广发证券股份有限公司-中康小盘价值股票型证券投资基金	未知	1.57	14,753,918	0	未知
华泰证券股份有限公司-中康价值主题混合型证券投资基金	未知	1.50	14,103,311	0	未知

前10名股东中,第一、第二、第三、第五大股东均为全国第一实际控制人中航工业的关联方,第四大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或在《上市公司收购管理办法》规定的期限内存在一致行动关系。前10名股东中,第一、第二、第三、第四大股东均为关联方,实际控制人中航工业的关联方,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或在《上市公司收购管理办法》规定的期限内存在一致行动关系。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司以提高运营质量为中心,以发展战略为牵引,以客户需求为导向,以绩效达成为目标,以精益管理为切入点,聚焦航空主业,加大改革创新,深化疫情快速反应,多措并举,狠抓疫情防控及生产经营双轮驱动,通过加大生产及市场开发力度,上半年基本实现了“时间、任务”双过半的经营目标,经营业绩和质量效益持续提升。同时,积极推进重点产品、重点市场、重点市场、围绕国际相关产业拓展,在新增、压降等环节业务领域持续推出重点项目,扩大生产产能,加大研发投入,取得一定成效。公司主要业务情况分析如下:

1 航空业务

2020年上半年,中航重机航空产业实现营业收入4.24亿元,同比增长17.68%,其中,航空业务实现营业收入20.46亿元,同比增长18.33%,占营收板块收入比为84.2%;非航空业务实现营业收入3.84亿元,同比增长14.2%,占营收板块收入比为15.80%。

在航空业务方面,爱迪、安发、景航公司维持现有客户,订单争取取得积极进展,国内市场稳步增长,订单可满足全年计划要求。

中航重机民用产品,公司民用产品主要以叶片为主,订单呈现稳健改革发展的持续性特征,火电叶片在产能提升的基础上,大型、超大型火电叶片及核电叶片需求相对趋于增长,目前新品设计试制,在生产质量提升、批产交付等工作持续推进中。安发公司加大工程机机、风电、燃气轮机等产品市场开发力度,市场竞争激烈,市场份额逐步减少,针对发展潜力较大的民用燃气轮机、高铁、高端机械等领域,将加大市场开发力度,集中优势资源对领域的重点客户进行突破。

2 液压环控业务

2020年上半年,液压环控产业实现营业收入8.93亿元,同比增长0.34%;其中,液压业务实现营业收入3.93亿元,同比增长4.57%,主要原因是受疫情因素影响,部分国内终端用户市场订单转换暂缓交付。

上海硅产业集团股份有限公司

2020 半年度报告摘要

股票代码:688126 公司简称:沪硅产业

公司2020年上半年主要经营情况分析如下:

1. 财务指标完成情况分析

截至2020年6月30日,公司的资产总额为1,175,273.28万元,较2019年底资产总额996,324.41万元增幅17.96%;负债总额为416,305.78万元,较2019年底负债总额478,880.50万元减少13.07%;股东权益为758,967.49万元,较2019年底股东权益517,443.91万元增幅46.68%。公司总资产和股东权益的增长主要是公司上半年募集资金增加所致。负债的减少主要是公司归还东股借款所致。

2020年1-6月,公司实现营业收入为85,427.37万元,较上年同期增长30.53%;归属于母公司股东净利润为-8,259.42万元,较上年同期亏损增加10.17%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96万元,较上年同期亏损增加25.57%。营业收入较上年同期增长30.53%,主要系2019年3月底并新增做衬,因此2019年同期中不包含新增衬这一块财务数据;同时由于上海新昇300mm硅片的销量持续提升,公司利润同比下滑主要是由于一方面公司产品持续加大研发投入,同时存货价值准备计提增加市场影响有所增加所致。

2020年上半年,公司经营产生的现金流量净额为2,736.44万元,较上半年经营活动产生的现金流量净额143,833万元增幅为56.92%,主要原因是由于2019年3月底并新增做衬,因此2019年同期中不包含新增衬一季度的财务数据所致。

2. 技术突破

公司继续推进国家重大科研项目及公司自主研发的工作,2020年上半年研发投入6,473.13万元,研发投入总额占营业收入比例为7.58%,较上年同期5.90%增加1.68个百分点。

公司研发投入与公司所处的行业发展阶段、承担的重大研发项目研发进度相一致,公司研发投入占营收人的比例高于同行业上市公司平均水平,并且公司研发投入并未受到盈利情况的影响,2020年上半年研发投入仍然保持在较高水平。

3. 产能提升

公司上海新昇正在推进募投项目即集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目的建设,300mm硅片正在集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目的基础上进行设备更新有所延迟,但通过后续进度的加快,预计在2020年底达到20万片/月产能的计划保持不变,子公司Okmetic、子公司新微科技通过去规模化和提高生产的方式,进一步提升产能。

4. 产品认证

公司300mm大硅片和200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)认证的产品数量持续增加,其中,300mm硅片通过研发和客户认证工作,按照进度要求继续推进20-14nm集成电路用300mm硅片制造技术研发与产业化(一)及(以下称“聚源项目”)、聚源项目二期项目即集成电路制造用300mm硅片制造技术研发与产业化(二)等研发项目,20-14nm技术先进的项目的推广和产业化进展,在拉粒、研磨抛光、工艺环境取得进一步突破,20-14nm技术先进的硅片和抛光硅片产品正在推进认证工作,针对CIS等应用开发的硅片产品也陆续通过或在认证过程中。

5. 对外投资

报告期内,公司根据自身发展战略规划,新增对外投资,投资对象分别为:湖北三维半导体制造创新中心(有限合伙)公司,持股4.31%;上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司,公司持股5.88%;上海集成电路材料研究院有限公司,公司持股25%。上述新增对外投资将进一步加强与上下游产业链的合作关系,整合国内集成电路产业创新资源,进一步巩固并深化与国内集成电路制造业龙头的合作研发关系,形成紧密合作的创新网络,上述新增对外投资也有利于公司硅片产品的联合研发、认证和销售,有利于公司拓展集成电路材料持续创新的深度和广度。

上海硅产业集团于6月6日完成对上海新昇持有的上海新昇15%的股权收购,使上海新昇成为公司全资子公司,有利于上海新昇的进一步发展和公司300mm硅片业务的一步拓展。

公司子公司上海新昇于2020年6月以自有资金认缴出资人民币30,000万元,作为有限合伙人参与投资并参股集成电路装备材料产业中心(有限合伙)(以下简称“聚源项目”)。聚源项目认缴出资规模为人民币230,500万元,作为战略投资者认缴出资的出资人在科创板首次公开发行的股票,公司间接持有战略投资者身份并参与中国聚源项目的决策,有利于进一步加强对聚源项目业务合作。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2020年1月1日,公司执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号收入》,具体请参考第十节财务报告第五(44)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2020-025

上海硅产业集团股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账金额、到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的证监许可[2020]450号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,上海硅产业集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)1,100,000,000股,每股发行价格为人民币3.89元,每股以人民币现金认购,募集资金总额计人民币4,286,900,000元,扣除发行费用人民币127,653,510.47元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币4,159,246,489.53元,上述募集资金已于2020年4月15日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字[2020]0303号验资报告。

(二)募集资金存放及结余情况

截至2020年6月30日,公司本年度使用募集资金金额为人民币143,853.01万元,累计已使用募集资金金额为人民币143,853.01万元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为477.14万元,累计收到募集资金利息和手续费净额为477.14万元,募集资金余额为人民币866,658.37万元,其中用于募集资金管理金额约为700.00万元。

截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币16,568.37万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

项目	金额(万元)
年初募集资金余额	230,034.24
减:本年募集资金使用项目	83,600.96
新增募集资金投资项目自筹资金	58,296.79
减:以前年度募集资金支付发行费用	1,449.82
本年度支付发行费及增值服务费	145.74
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	477.14
减:用于现金管理金额	700,000.00
募集资金专户期末余额	16,568.37

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金管理(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2019年4月修订)等相关规定的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”),对募集资金专户存储制度、对募集资金存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,该办法已于公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2020年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额(万元)
上海银行浦东支行	上海硅产业集团股份有限公司	3198130300490257	活期	209.38
中国工商银行上海浦东高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	446879415963	活期	4.05
招商银行上海浦东支行	上海硅产业集团股份有限公司	12912770510868	活期	16,534.94
	总计			16,568.37

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所有关规定的要求,公司及保荐机构已于2020年4月1日、2020年4月1日、2020年5月21日分别与保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金专户存储制度、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,该协议已于公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2020年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

(三)2020年半年度募集资金实际使用情况

1. 募集资金使用计划对照表

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所有关募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)等相关规定,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2020年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期内”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

(一)募集资金基本情况

1. 募集资金到账金额、到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的证监许可[2020]450号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,上海硅产业集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)1,100,000,000股,每股发行价格为人民币3.89元,每股以人民币现金认购,募集资金总额计人民币4,286,900,000元,扣除发行费用人民币127,653,510.47元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币4,159,246,489.53元,上述募集资金已于2020年4月15日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字[2020]0303号验资报告。

(二)募集资金存放及结余情况

截至2020年6月30日,公司本年度使用募集资金金额为人民币143,853.01万元,累计已使用募集资金金额为人民币143,853.01万元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为477.14万元,累计收到募集资金利息和手续费净额为477.14万元,募集资金余额为人民币866,658.37万元,其中用于募集资金管理金额约为700.00万元。

截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币16,568.37万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

序号	受托银行	产品名称	投资金额(万元)	认购日	到期日	收益类型	期限(天)	是否到期
1	上海银行股份有限公司	7天通知存款	50,000.00	2020.05.14	2020.06.18	保本浮动收益	2,025.096	是
2	上海银行股份有限公司	7天通知存款	50,000.00	2020.05.18	2020.06.18	保本浮动收益	2,025.096	是
3	上海银行股份有限公司	7天通知存款	59,680.00	2020.06.18	2020.07.01	保本浮动收益	2,025.096	否
4	上海银行股份有限公司	7天通知存款	41,000.00	2020.06.18	活存	保本浮动收益	2,025.096	否
5	招商银行股份有限公司	结构性存款	16,500.00	2020.05.29	2020.06.29	保本浮动收益	3,000.006	是
6	招商银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2020.06.22	2020.07.24	保本浮动收益	2,990.06	否

四、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照募集资金管理制度的要求,真实、准确、完整、已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件:1.募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表											
单位:人民币元											
募集资金总额	2,284,389,787.53	本年度投入募集资金总额		1,422,577,491.86							
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额		1,422,577,491.86							
变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额比例		62.31%							
承诺投资项目	承诺金额占募集资金总额的(%)	调整后投资总额	截至期末投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额占募集资金总额的(%)	截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年是否达到预定可使用状态	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明	
集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目	无	1,599,072,851.27	1,599,072,851.27	1,599,072,851.27	737,265,558.60	-861,813,292.67	46.11%	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	685,316.26	685,316.26	685,316.26	685,316.26	0.00	100%	不适用	不适用	否	
合计	-	2,284,389,787.53	2,284,389,787.53	2,284,389,787.53	1,422,577,491.86	-861,813,292.67	-	-	-	-	

未达到计划进度原因(分项目明细):不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明:不适用。

2020年5月29日,公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了